



自动激光植线式锡焊系统简介

常规焊锡所面临的困难:

1、人工烙铁头焊接:

受员工技能和心情等因素影响,常易烫伤焊接位置周边部件和静电影响致焊接质量不稳定。此种焊接需要大量熟练工才能完成,人员成本,管理成本都会相应增加,无法高效的实现微小器件的精密焊接。

2、激光锡膏焊接:

1. 因锡膏坍塌性,激光焊接过程中锡膏产生形变致反射较严重,焊接周边有灼伤不良;
2. 锡膏焊接特性,激光焊接时易产生飞溅和残留;
3. 锡膏的流动性会致使出锡量可控性差,且易堵塞针头;
4. 锡膏储存麻烦,需冷藏解冻;
5. 成本问题(相比较锡线偏高);

针对以上各项问题,深圳市艾贝特电子科技有限公司专门开发了系列激光精密焊锡系统,来满足各种精密焊接的需要。

艾贝特焊接方案的优点(激光植锡线式):

1. 锡线和锡球储存方便(常温);
2. 此工艺应用线圈马达相比较锡膏而言无飞溅、无残留;
3. 可精准控制送锡量和焊接位置;
4. 保证焊接良率稳定性;





5. 锡线、锡球成本较锡膏低。

产品介绍:

产品以托盘方式自动进入焊接工位——通过 CCD 识别定位——自动、精准、定量裁剪并提取锡线至焊接位置——自动激光焊接——自动流进下一工位。

产品特点:

生产节拍 3s(双轨)和 5s(单轨)可选，良率 98%以上；
焊锡效率高，尤其适合多焊点大批量生产，可以连续不间断进行加工；
自动化程度高，盘进盘出，与上下工位无缝对接，实现高度全自动化生产；
全封闭结构，加工无污染，操作使用安全。

技术优点:

锡线定量，一体成型，没有锡溅、残留等问题；
焊接效果优良，焊点饱满，一致性好；
CCD 成像实时观察加工情况；
设备扩展功能强，适合加工多种复杂加工工件情况；
加工程序可编辑，便于操作。

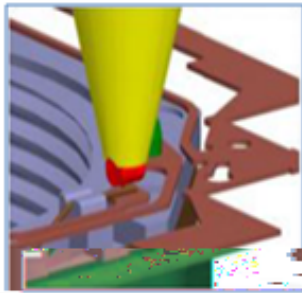
应用领域:

适用 VCM 马达线圈焊接，软性线路板 FPC 或硬性线路板 PCB 焊，高精密的液晶屏 LCD 焊等领域。

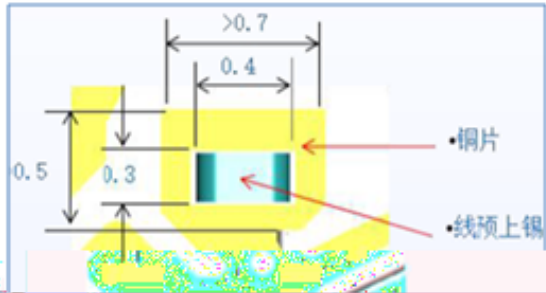
样品介绍:



锡线放线



参考尺寸



焊接效果

